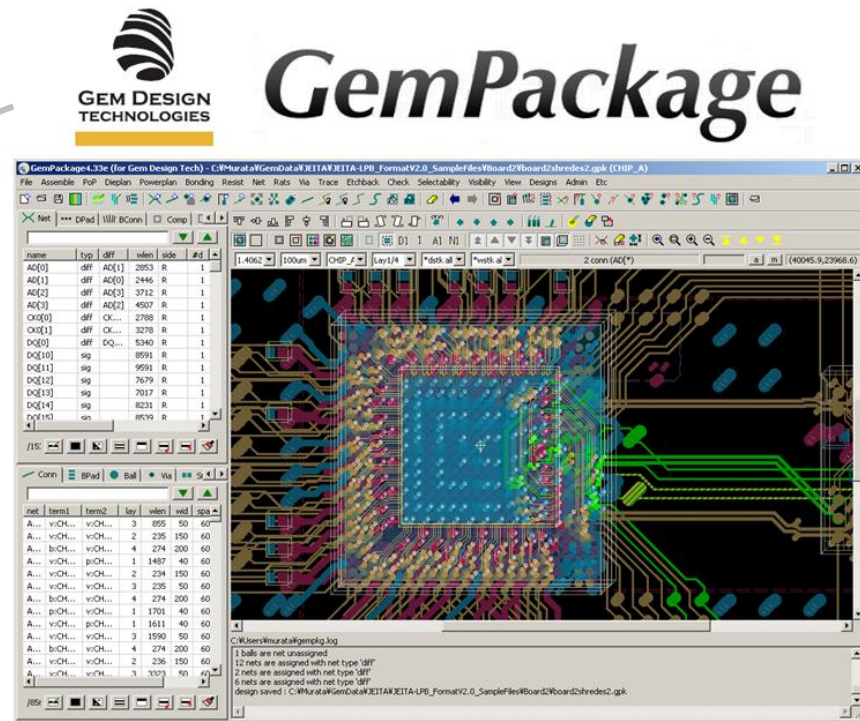
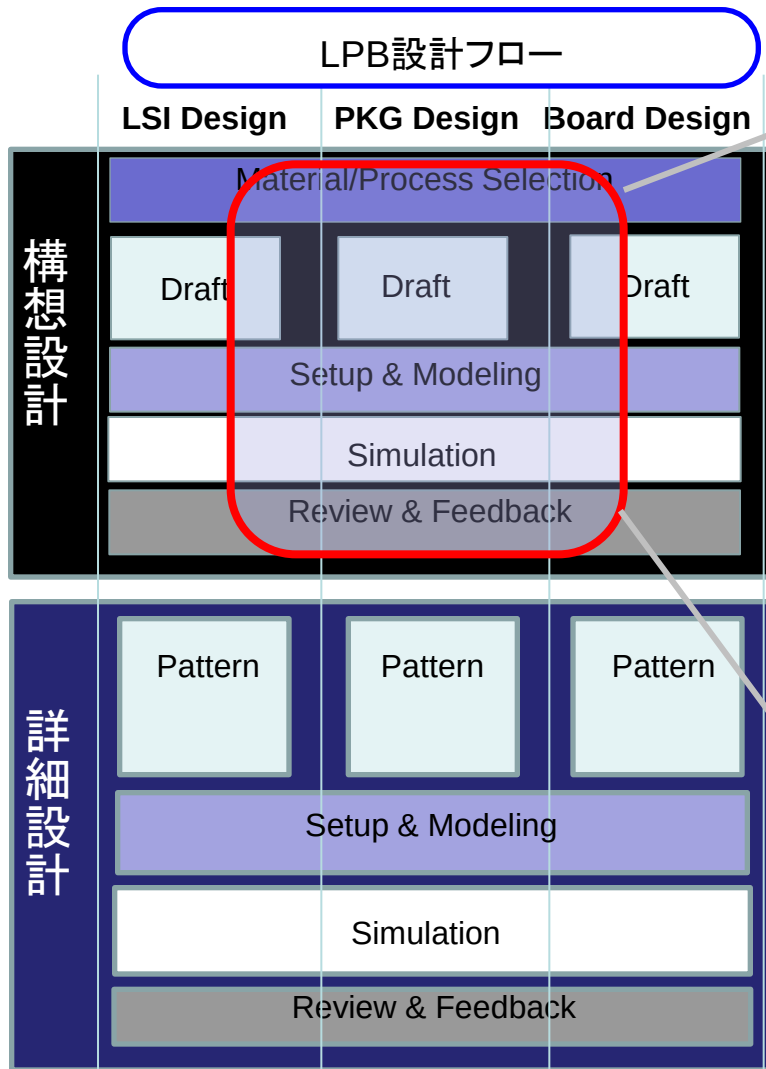


LPBを応援します GemPackage

(株) ジェム・デザイン・テクノロジーズ 村田洋



GemPackageとは 構想設計向きのPKG設計ツールです



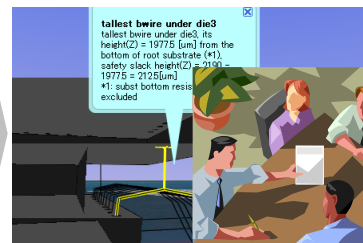
LPBの構想設計段階において、LSI・ボードの両方からの要求に対して、チップパッドとパッケージボールの接続検討を迅速に行うことができ、検討結果のパッケージ形状データをSI/PI/T/M解析ツールに出力することができる、設計ツールです。



人の連携を助けます

半導体チーム内のコ・デザイン

Mr.Board, Mr.Package, Mr.Chip



デザインレビュー

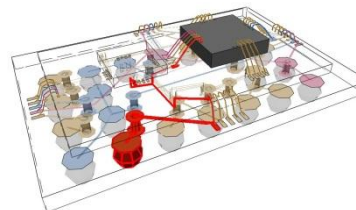


“よし！いけそうだ”

GemPackage

お客様-ベンダ間のコ・デザイン

Mr.System

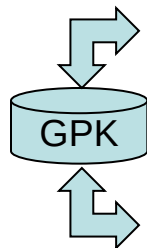


確認・検証



“よし！やってくれそうだ。”

GemView/Free



GEM DESIGN
TECHNOLOGIES

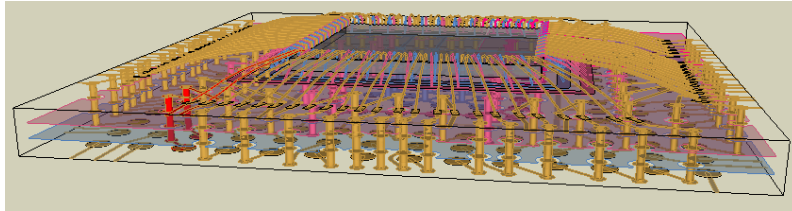
Gem Design Technologies, Inc.

GemPackage -- IC Package Co-Design Tool

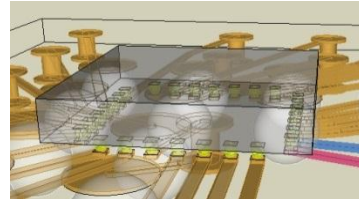
slide 3 of 23



いろんな構造タイプに使えます



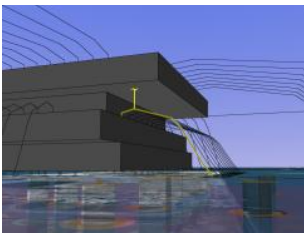
PBGA/FBGA



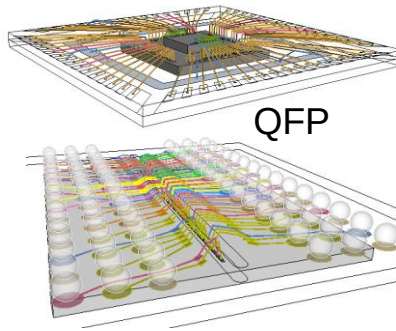
Flip Chip



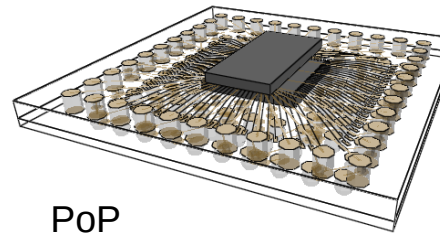
CPB SH-Design
Chip-Package-Board Super-Hierarchical Design



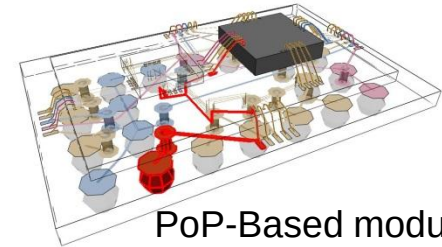
Chip Stacked



QFP

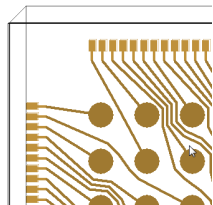


PoP

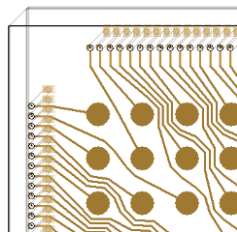


PoP-Based module

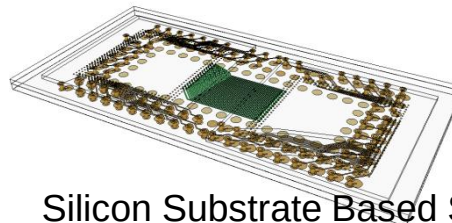
Window BGA



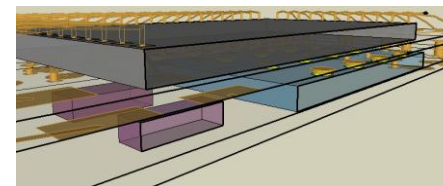
WLCSP



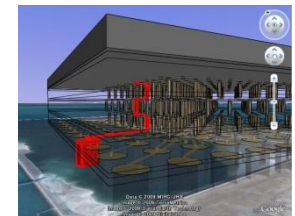
TSV-Based WLCSP



Silicon Substrate Based SiP



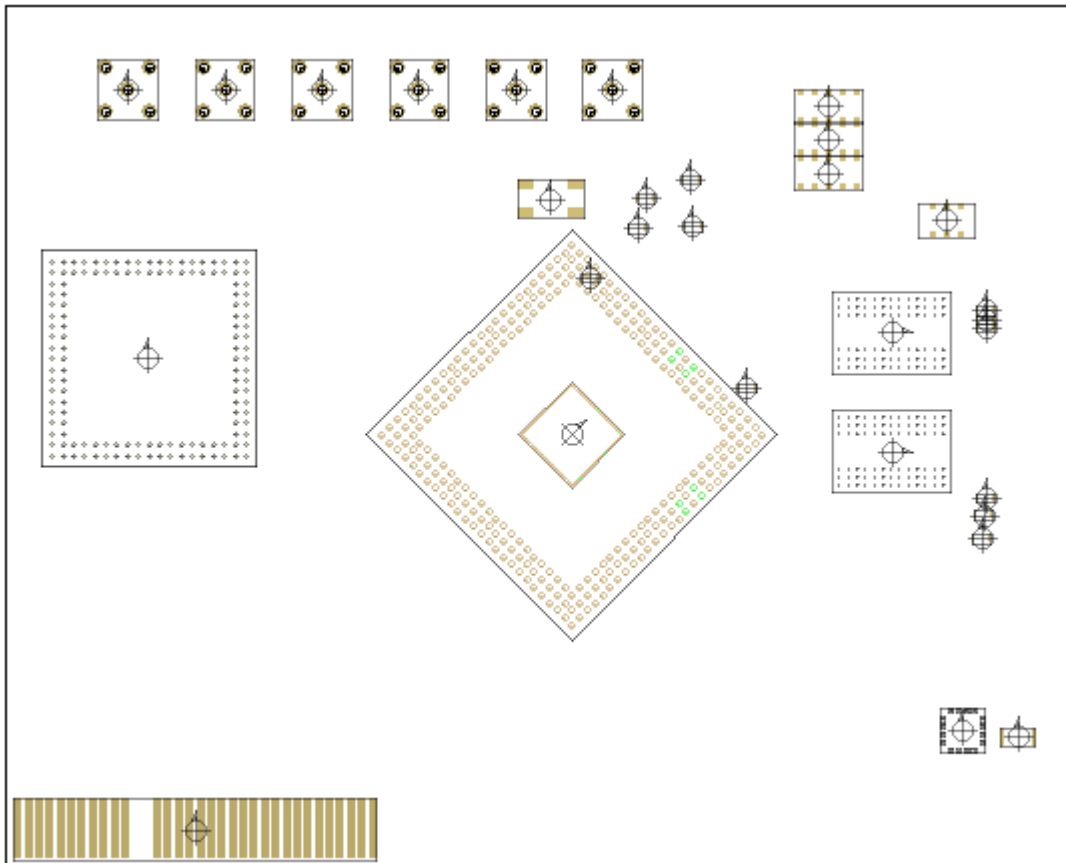
Embedded Substrate



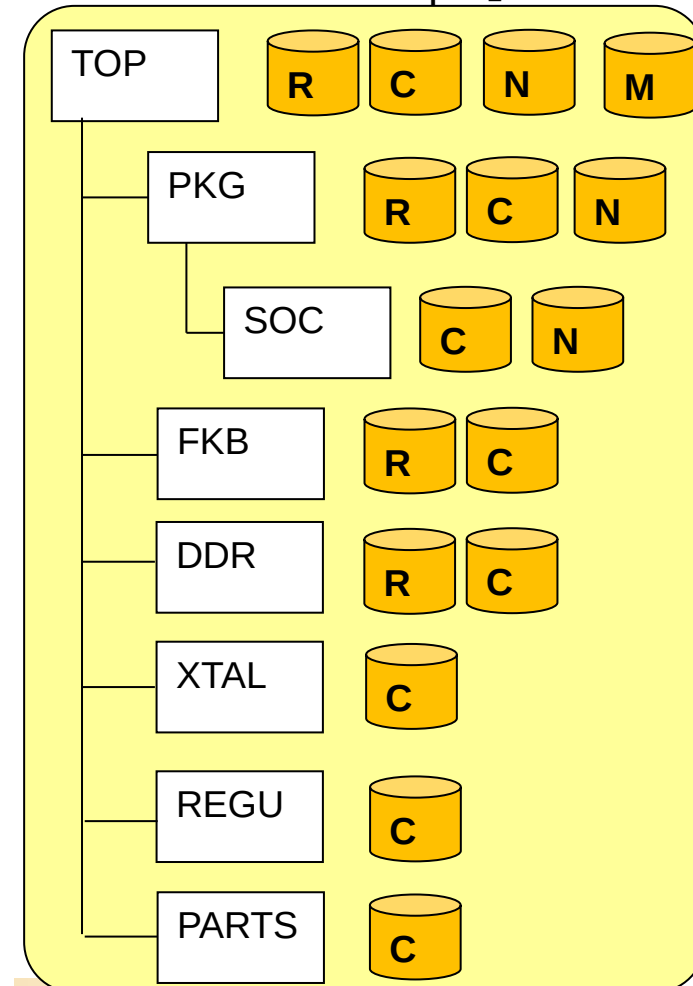
3D-IC

LPB フォーマットを業界に先駆けてサポート トしています

R(ルール), C(部品), G(ジオメトリ)の3フォーマットを入出力の双方向でサポートしています。バージョンは2.1を既にサポートしています。LPBのV2.1ではCフォーマットの独立性が高まっており、Gemではそれを生かし、ユーザがLPBファイルを準備しておいてくれば、チップ-パッケージ-ボードの全体配置と設計ルール設定が一気に生成できるようになりました。

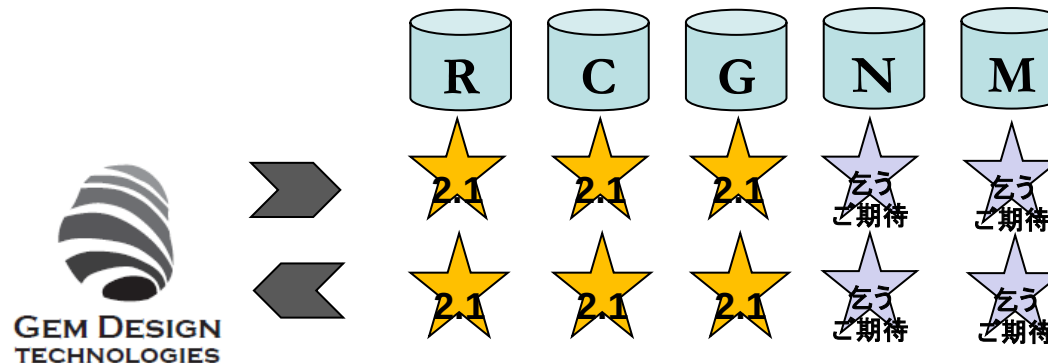


LPB2.1に同梱される
「Golden Sample」



GemはLPBを応援します

- 2012年度はJEITAに加わり2.1改定作業に協力させていただきました。
 - 半導体皆様の元気を感じることができました。
 - ユーザ主導のフォーマットで企業間の協調を目指す、という進め方に明るい未来を感じました。
 - フォーマット策定現場に参加させていただくことで弊社開発を加速できました。
- 2013年度は弊社製品における対応をさらに進めます。



- またLPB Forumサイトの場合などで、微力ながら皆様の応援もしたいと考えています。
 - ユーザ皆様のLPB活用議論への参加
 - EDA同業皆様からのフォーマット細部に関する質問へのノウハウご提供など

Thanks

Hiroshi Murata
murata@gemdt.com

Gem Design Technologies, Inc.
<http://www.gemdt.com/>